



广东省某球形硅微粉及 EMC 生产项目
商业计划书案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

第一章 项目摘要

一、项目名称

二、项目公司名称

三、项目主要产品

球形硅微粉

环氧塑封料（EMC）

四、市场概况和营销策略

受全球半导体产业技术进步影响，高端集成电路比例不断提升，球形硅微粉主要应用的塑封材料保持稳定增长。半导体塑封料 2013-2015 全球产值分别为 24.51、27.12 和 29.22 亿美元，分别占当年全球半导体材料产值的 5.69%、6.16% 和 6.73%，保持较稳定增长。

主要采用：

- 1、差异化营销策略：
- 2、整合营销策略：
- 3、关系营销策略：

五、核心经营团队

第二章 公司概况

第一节 公司基本情况

一、项目公司简介

二、公司组织结构

第二节 项目公司团队介绍

一、项目团队

二、项目团队核心成员介绍

第三章 项目产品与工艺技术

第一节 项目产品介绍

一、产品介绍

二、项目产品方案

三、项目产品优势

四、应用领域

第二节 产品工艺技术

一、球形硅微粉工艺技术方案选择

二、环氧塑封料（EMC）的工艺选择

第三节 项目设备方案

一、设备方案选型原则

二、设备投资及清单

第四节 原辅材料消耗及来源

第四章 商业模式

第一节 经营模式

一、采购模式

二、生产模式

三、销售模式

第二节 盈利模式

一、本项目盈利模式

二、本项目收入明细

第五章 项目所在行业市场分析

第一节 我国硅微粉行业市场分析

一、硅微粉产业布局情况

二、硅微粉的行业现状

三、硅微粉行业利润情况

四、硅微粉企业规模

五、硅微粉产业发展中存在的问题

六、硅微粉行业发展趋势

第二节 球形硅微粉行业市场分析

一、球形硅微粉行业市场需求分析

1、全球球形硅微粉市场需求分析

按在中国大陆地区建厂和本土的主要 EMC 厂商的产能计算，硅微粉原料年需求量约 15 万吨，其中球形硅微粉需求量约 10 万吨。

图表 16：全球主要 EMC 厂商球形硅微粉需求量

国家/地区	厂商	球形硅微粉消耗量 (吨/年)
日本	住友电木 Sumitomo Bakelite	33600
	日东电工 Nitto Denko	12000
	日立化成 Hitachi Chemical	12000
	信越化学 Shin-etsu Chemical	6600
	京瓷化学 Kyocera Chemical	1800

国家/地区	厂商	球形硅微粉消耗量 (吨/年)
	松下电工 Matsushita Electric Eorks	2400
德国	衡山华威电子 Henkel Huawei	2400
中国台湾	长兴材料工业	1800
	义典科技 E'dale Technology	2400
	长春集团	240
	品日东进 C&L Dongjin	600
韩国	三星 SDI Samsung SDI	3600
	金刚高丽化学 KCC	2400
	纳沛斯 NEPES	1800
新加坡	确信电子 Cookson	1200
	合计	84840

二、球形硅微粉行业国内外生产现状分析

三、球形硅微粉行业市场前景分析

四、销售预测

第三节 环氧塑封料（EMC）行业市场分析

一、产品定义

二、环氧塑封料（EMC）行业生产状况

图表 22：全球主要 EMC 厂商产能

国家/地区	厂商	产能 (吨/年)	备注
日本	住友电木 Sumitomo Bakelite	50400	本国工厂
	日东电工 Nitto Denko	33600	塑封料业务被日东并购
	日立化成 Hitachi Chemical	30000	本国工厂
	信越化学 Shin-etsu Chemical	15600	本国工厂
	京瓷化学 Kyocera Chemical	28800	本国工厂
	松下电工 Matsushita Electric Eorks	21000	本国工厂

国家/地区	厂商	产能 (吨/年)	备注
德国	汉高华威电子 Henkel Huawei	36000	中国工厂
中国台湾	长兴材料工业	7200	当地工厂
	义典科技 E'dale Technology	6000	当地工厂
	长春集团	6000	当地工厂
	品日东进 C&L Dongjin	6000	当地工厂
韩国	三星 SDI Samsung SDI	10800	本国工厂
	金刚高丽化学 KCC	7200	本国工厂
	纳沛斯 NEPES	6000	本国工厂
新加坡	确信电子 Cookson	7200	塑封料业务被松下并购
合计			271800

三、环氧塑封料行业市场需求分析

四、环氧塑封料行业市场规模

五、环氧塑封料行业进口情况

第四节 EMC 下游应用（集成电路行业）市场分析

一、我国集成电路市场需求旺盛

二、巨大的市场需求和国家产业政策的大力支持，带动了我国集成电路产业快速增长，并形成了较为完整的产业链格局，在细分行业涌现出一批实力较强的代表性企业

三、我国集成电路国产化需求强烈

第五节 项目目标市场分析

一、项目国内销售市场划分

二、项目国外目标市场划分

三、项目产品销售市场预测

第六节 SWOT 分析

一、优势

二、劣势

三、机会

四、威胁

第七节 项目竞争分析

第六章 项目发展目标及策略

第一节 项目宗旨

第二节 项目发展目标

一、整体目标

二、各阶段性目标

第三节 项目营销策略

一、差异化营销策略

二、整合营销策略

三、关系营销策略

第七章 项目投资计划

第一节 项目融资方案

第二节 资金使用计划

第一阶段资金投放情况如下，主要包括项目基建费用和设备购置费。

图表 41：球形硅微粉及 EMC 生产项目基建

序号	项目	建筑面积(m ²)	建筑工程费（万元）
1	主要建设内容		
1.1	原料库		
1.2	主生产车间		
1.3	成品库		
1.4	机修车间		
1.5	办公楼		
1.6	研发中心		
2	其他		
2.1	道路		
2.2	绿化		
2.3	停车场		
3	合计		

第三节 资金退出机制

第八章 项目效益估算

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第二节 估算基础

第三节 经营业绩

一、营业收入和税金测算

二、工资福利及其他相关费用

三、利润测算

四、财务指标测算

五、不确定性分析

六、财务评价结论

第四节 创业骨干股权、期权激励

一、激励的进入机制

二、退出机制

第九章 项目风险识别与防控

第一节 项目开发的运作风险及防范

一、运作风险及防范

二、工程风险及防范

第二节 项目本身潜在的风险及防范

一、政策性风险

二、市场风险

三、技术风险

四、不可抗力风险分析及控制

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806